



株式会社バイ・テクノロジー
2026年3月期(第29期) 中間決算

決算説明資料

(2025年4月1日～2025年9月30日)

2025年11月13日

| 目次

2026年3月期(第29期) 中間決算

1. 決算概況
2. 受注高・受注残高
3. 2026年3月期 業績予想と配当
4. ROE目標について
5. 企業価値向上に向けて、成長戦略と事業の状況
6. 主要財務データ
7. 付属資料

2026年3月期（第29期） 中間決算

1. 決算概況

1. 決算ハイライト

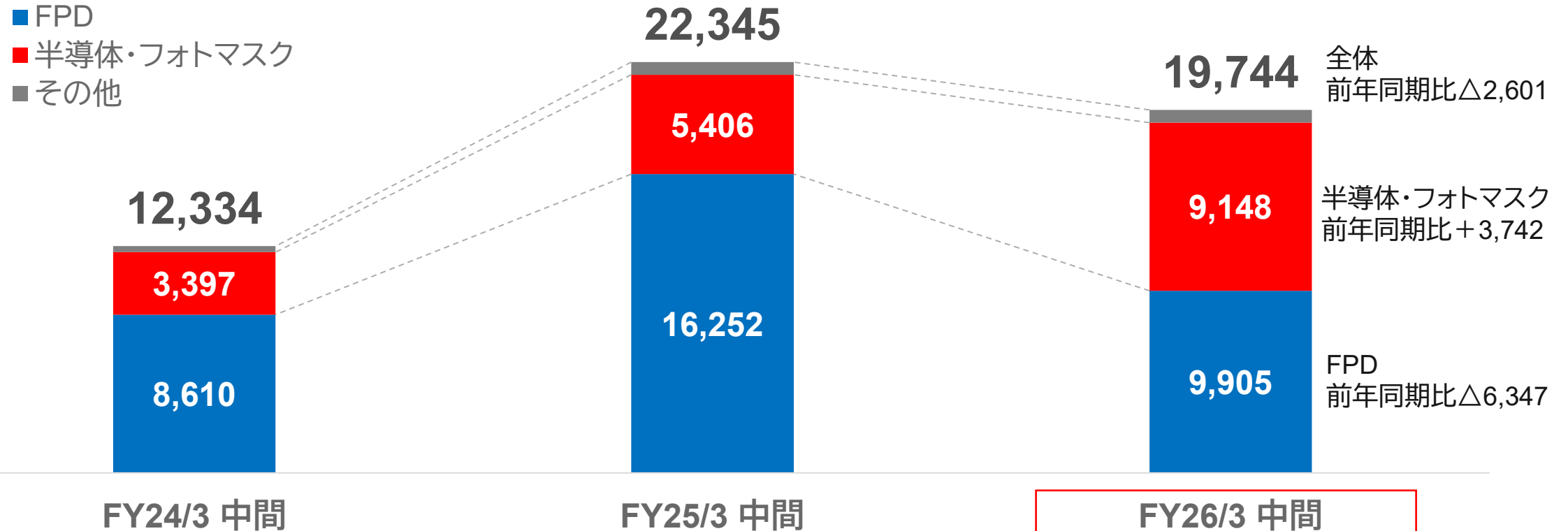
(単位:百万円)	FY24/3 上期	FY25/3 上期	FY26/3 上期	前年同期比 増減金額	前年同期比 増減率
売上高	12,334	22,345	19,744	△2,601	△11.6%
営業利益 (△損失)	△880	△136	△370	△234	—
営業利益率	—	—	—	—	—
経常利益 (△損失)	△592	△275	△406	△131	—
親会社株主に 帰属する 四半期純利益	△647	△218	△239	△21	—

2. 売上高増減要因(前年同期比)

連結売上高は、FPD装置事業の売上減により前年比で減少したものの、概ね会社想定で推移

- ✓ FPD装置事業……………前年の大型案件が一巡し減少
- ✓ 半導体・フォトマスク装置事業……大幅に拡大、成長軌道に

(単位:百万円)

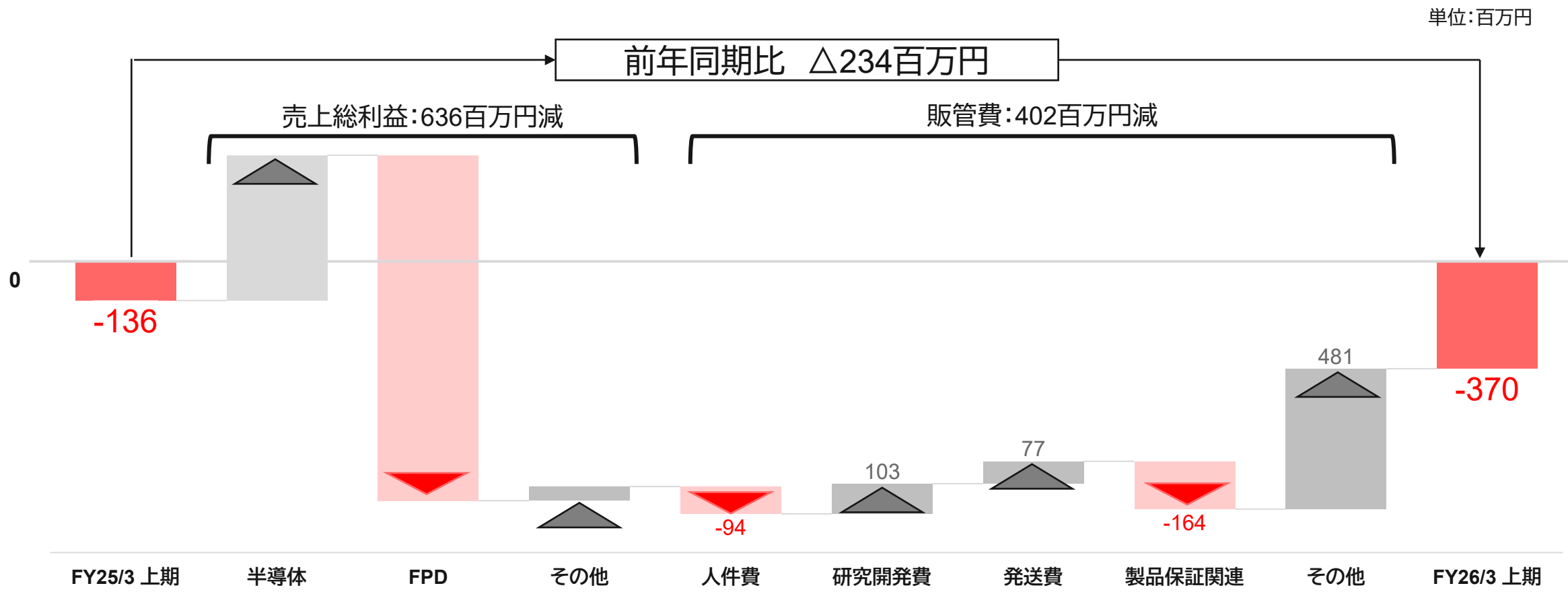


サブセグメント情報についてはP26をご参照ください。 5

3. 営業利益増減要因(前年同期比)

会社想定で推移、営業損失が前年同期比で増加した主な理由はFPD装置の売上減による。

- ✓その他費用:481百万円について
 - ・ 主に、販売手数料関連の抑制、のれん償却費の減少等による

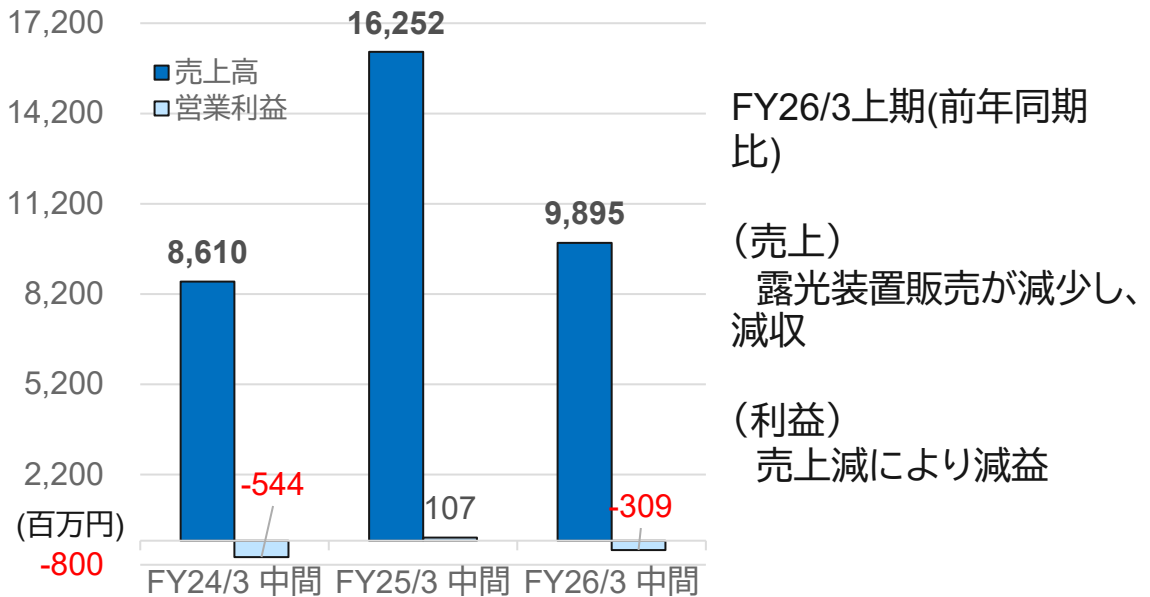


4. セグメント別 売上高・営業利益分析

FPD装置事業

- 大手顧客向け露光装置の設置が一巡したことで、大幅減収、営業損失拡大

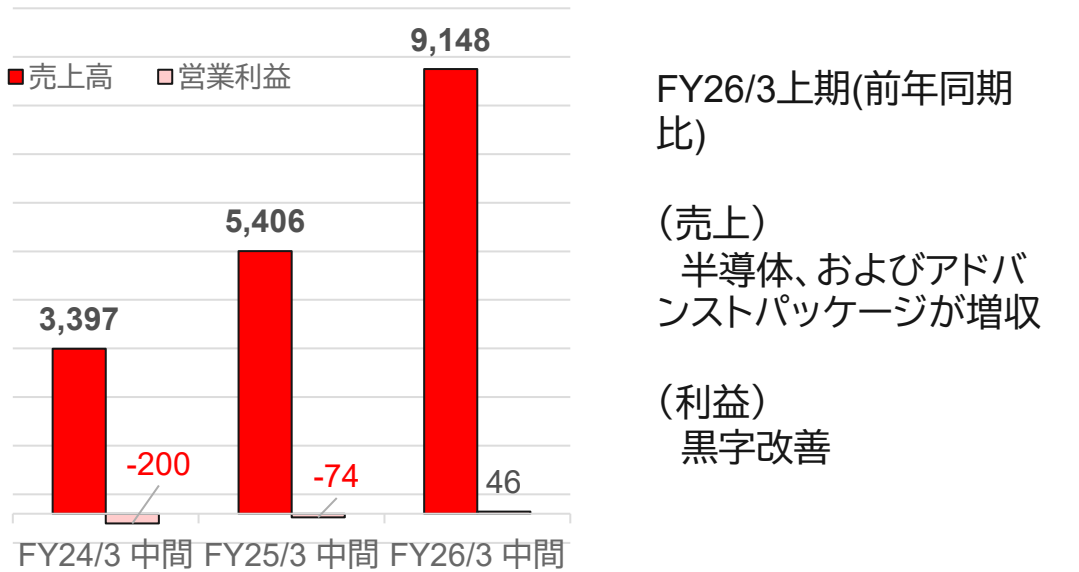
(単位:百万円)	FY24/3 上期	FY25/3 上期	FY26/3 上期	前年同期比	変化率
売上高	8,610	16,252	9,905	△6,347	△39.1
営業利益	△544	107	△309	△416	—



半導体・フォトマスク装置

- 主に(サブセグメントの)半導体の売上拡大により黒字転換、想定に対しスローな展開

(単位:百万円)	FY24/3 上期	FY25/3 上期	FY26/3 上期	前年同期比	変化率
売上高	3,397	5,406	9,148	3,742	+69.2%
営業利益	△200	△74	46	120	—



サブセグメント情報についてはP26をご参照ください。 7

2026年3月期（第29期） 中間決算

2. 受注高・受注残高

1. 受注高・受注残高の概況

FPD、半導体・フォトマスクともに、概ね想定線で推移

受注高：前年同期比**210**百万円の減少

・FPDは受注高が9,304百万円、半導体・フォトマスクは7,346百万円

受注残高：前年同期比**8,956**百万円の増加

・FPDは受注残が24,216百万円、半導体・フォトマスクは17,055百万円

来期売上高**660**億円の達成に向けて

・2026年3月末時点の受注残460億円(装置販売の8割程度)を目標に、半導体・フォトマスクの受注活動に注力

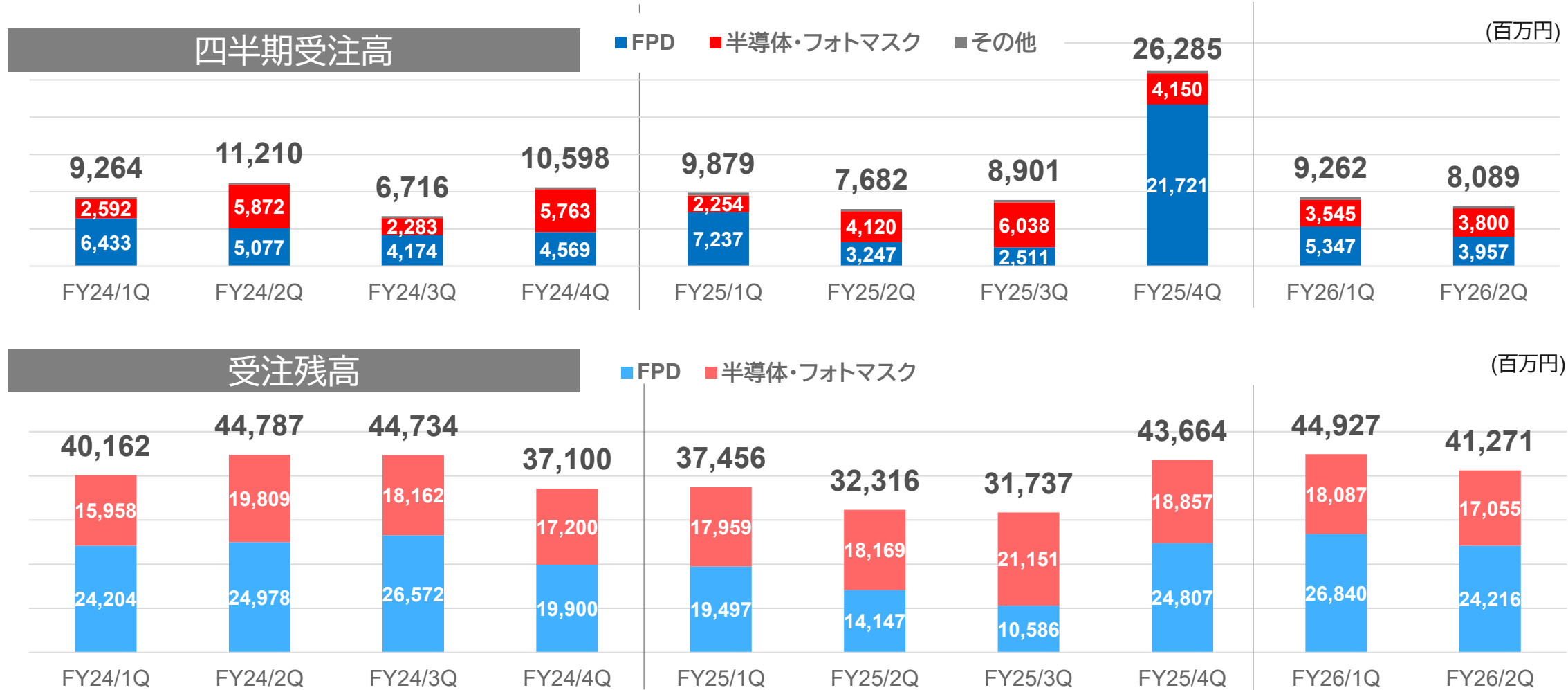
(単位:百万円)	FY25/3 上期	FY26/3 上期	前年同期比 増減金額	前年同期比 増減率	(参考) 通期予想
受注高	17,561	17,351	△210	△1.2%	—
受注残高	32,316	41,272	8,956	+27.7%	46,000

2. セグメント別 受注高・受注残高分析

(単位:百万円)		FY25/3 上期	FY26/3 上期	前年同期比 増減金額	前年同期比 増減率	事業概況
FPD装置	受注高	10,484	9,304	△1,180	△11.3%	前年同期比で、露光装置が増加、検査装置が減少
	受注残高	14,147	24,216	10,069	+71.2%	露光・修正装置を中心に、下期の売上計上を想定
半導体・ フォトマスク 装置	受注高	6,374	7,346	972	+15.2%	・ フォトマスクの受注が再開 ・ アドバンストパッケージは、一部案件が下期に延伸
	受注残高	18,168	17,055	△1,113	△6.1%	下期および来期計画達成に向け、アドバンストパッケージ分野を中心に受注活動に注力

3. 四半期受注高・受注残高の推移

FPD装置の大型受注は一巡、今後は半導体・フォトマスク関連の受注拡大を想定



2026年3月期（第29期） 中間決算

3. 業績予想と配当

2026年3月期業績予想の変更なし

- 半導体・フォトマスクの高採算案件が下期に本格寄与へ

(単位:百万円)	FY25/3 上期	FY25/3通期	FY26/3 (通期予想)	FY26/3上期	前年同期比 増減金額	前年同期比 増減率
売上高	22,345	46,182	56,000	19,744	△2,601	△11.6%
営業利益 (△損失)	△136	1,821	4,500	△370	△234	—
営業利益率	—	3.9%	8.0%	—	—	—
経常利益 (△損失)	△275	1,891	4,200	△406	△131	—
当期(四半期) 純利益(△損失)	△218	800	2,700	△239	△21	—

業績計画達成に全社的に取り組むと同時に安定配当を目指す

- 配当政策
 - ✓ 事業拡大に向けたM&A、設備投資等、経営基盤の強化に向けて、必要な内部留保の充実を勘案した上で、配当の安定性・継続性・配当性向等を考慮
 - ✓ 経営成績に応じた利益還元を行なう方針
- 今期配当予想について
 - ✓ 予想の変更無し、中間配当は、当初計画通り。期末配当は、今期業績結果等を踏まえ積極的な利益還元も検討予定
- 株主還元の充実を図るため、機動的な自己株式取得等、引き続き検討

項目		FY21/3	FY22/3	FY23/3	FY24/3	FY25/3	FY26/3(予想)
配当金額(総額/百万円)		1,176	1,176	882	586	764	756
配当性向(%)		21.40	30.60	334.70	74.20	95.20	28.00
一株当たり 配当金(円)	中間	60	60	60	30	40	40
	期末	60	60	30	30	40	40
	総額	120	120	90	60	80	80

4. ROE目標について

	FY25/3	FY26/3(予)	FY27/3(予)	FY29/3(予)
ROE	2.4%	8.2%	12.5%	23.7%

1. 最終利益の極大化

① 売上高の増加

- ・ 既存ビジネスの伸長、新規ビジネスの取組、M&Aを活用、インドへの事業展開

② 利益率UP

- ・ 高利益率事業へのシフト(不採算事業からの撤退、高付加価値製品事業への取組・伸長、中国国産化)
- ・ コストダウン(生産拠点のグローバル化の進展、リードタイム短縮、子会社統合・再編)

2. 株主還元の取組み

① 利益水準に応じた積極的な配当

② タイムリーな自社株買い

5. 企業価値向上に向けて、 成長戦略と事業の状況

<目次>

1. FPDから半導体へ
2. アドバンストパッケージ・PCB
3. フォトマスク
4. 半導体とFPD装置事業
5. 企業価値向上に向けて
6. 中期経営計画について

1. FPDから半導体へ(1) ～FPD装置事業～

事業環境が急激に変化する中、FPD装置のM&Aを推進し事業を拡大

FPD技術：LCDとOLEDが市場に浸透

技術\用途	モニタ	TV	ノートPC	スマートフォン	ウェアラブル	AR/VR	サイネージ
PDP(~2013)	×	○	×	×	×	×	△
LCD	◎	◎	◎	○	◎	○	◎
OLED	○	○	○	◎	○	○	×
Mini-LED	×	△	×	×	×	×	◎
μ-LED	×	×	×	×	△	○	×
電子ペーパー	×	×	×	×	×	×	△

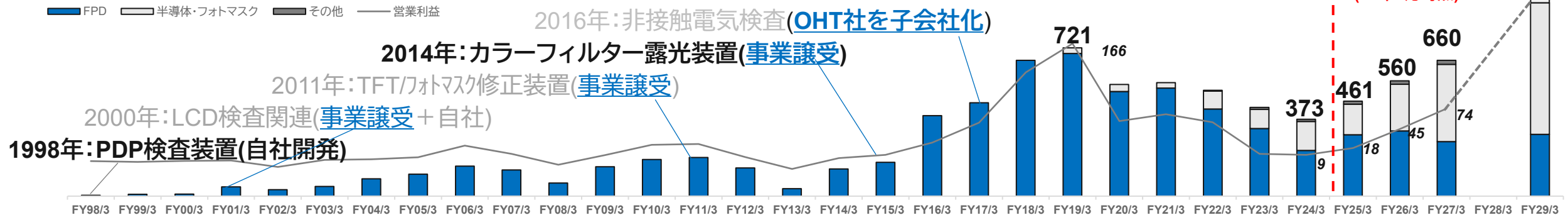
普及度(◎>○>△>×)

産地：現在のFPDの主要顧客は中国に集中



……インド政府がFPD産業への大規模な投資を検討中

主要事業と、売上高および営業利益の推移(単位:億円)



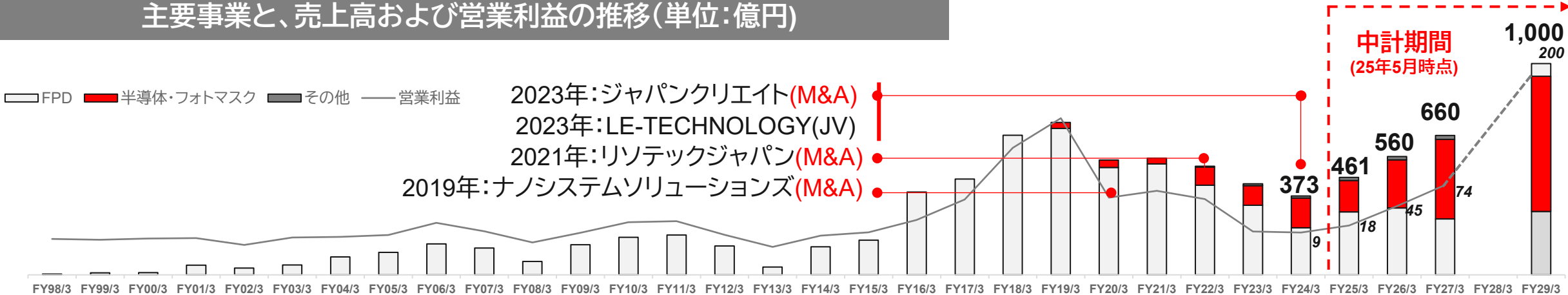
1. FPDから半導体へ(2) ～半導体・フォトマスク装置事業～

2026年3月期中間決算
5. 企業価値向上に向けた
成長戦略と事業の状況

半導体に係る日本が強い分野へ参入・・・装置事業は顧客との共同開発が不可欠

参入市場	業界を代表する企業名	当社グループ	主要製品
シリコンウェハ	信越化学工業、SUMCO、他	ナノシステムソリューションズ ジャパンクリエイト	シリコンウェハ検査、洗浄
フォトマスク	テクセンドフォトマスク、DNP、HOYA、他	ブイ・テクノロジー	検査装置(Vテクオリジナル製品)
レジスト材料	JSR、レゾナック、味の素、他	リソテックジャパン	研究室用レジスト評価装置
アドバンストパッケージ	イビデン、新光電気工業、 TOPPANホールディングス、他	LE-TECHNOLOGY オー・エイチ・ティー	DI露光装置、オープンショートテスト、 マイクロプローブ

主要事業と、売上高および営業利益の推移(単位:億円)

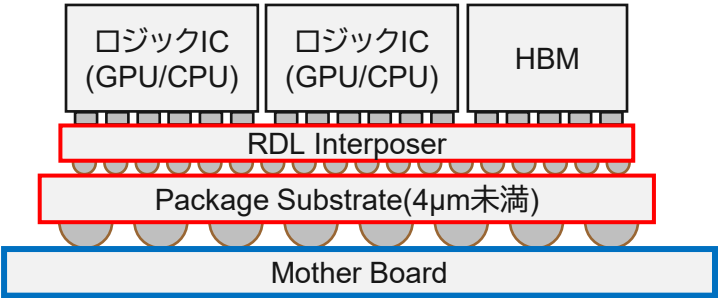


2. アドバンストパッケージ・PCB

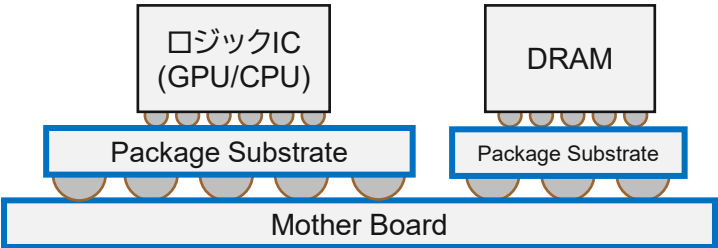
AI用半導体パッケージの分野に集中

半導体パッケージ……注力分野(赤枠)と、協業分野(青枠)

AI用半導体パッケージ(アドバンストパッケージ)
……………チップレット(2. xDパッケージ)



PC、スマートフォン等用半導体パッケージ
……………FC-BGA、FC-CSP



PCB……露光工程の周辺にも展開

DI露光装置

CFMEE

芯基微装

中国シェアNo1

露光工程周辺

ウェット装置

印刷装置

検査装置、他

露光の周辺工程へリユージョンを展開

アドバンストパッケージ分野における、当社製品の状況

下記製品が主に関係する最終製品			AI半導体(インターポージャー他)	次世代AI半導体
当社製品	DI露光(LAMBDIシリーズ)		稼働中	2025年7月出荷済
	O/Sテスト	本体(LIBRA)	受注済	開発中
		検査治具(μプローブ)		

3. フォトマスク

製品ラインナップを拡充しつつ、更新需要に対応

更新需要は一定の規模感で推移する見通し

1. レガシー半導体*の生産能力は依然拡大傾向

*パワー半導体、産業用半導体等

2. 関連するフォトマスクの製造装置の老朽化**

**アフターサービス終了対象の設備が増加

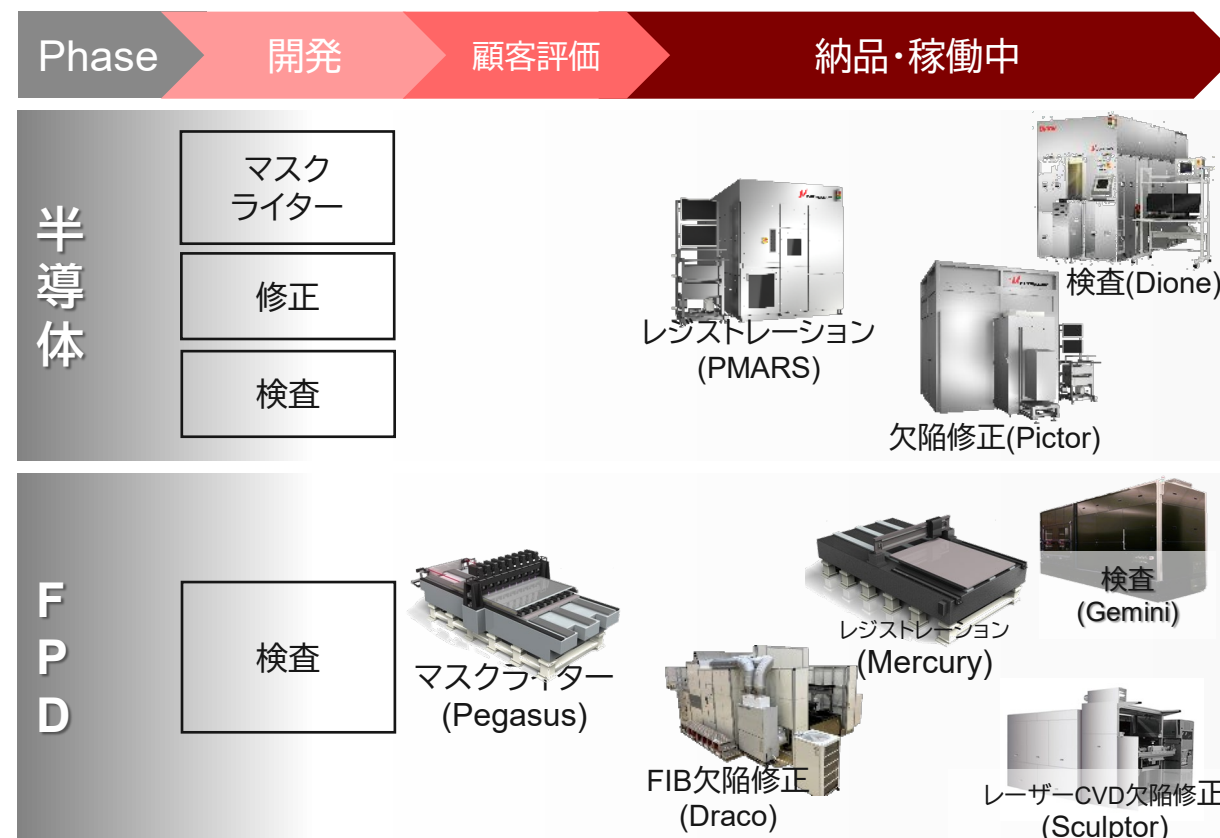
更新需要の獲得に向けて

1. 既存設備との互換性、信頼性、スループット
2. 価格競争力
3. 海外展開強化



中国無錫
CSEACへ出典

既存製品のシェア拡大+次の成長ドライバの開発加速



4. 半導体とFPD装置事業

半導体……主力製品の海外シェア拡大および、新しい分野に向けた新製品の開発
FPD装置事業……トップサプライヤーとしてのポジションを堅持

半導体：主力製品の海外シェア拡大と新製品開発		
ナノシステムソリューションズ(NSS)	リソテックジャパン(LTJ)	ジャパנקリエイト(JAC)
主力製品 	主力製品 	主力製品 
Siウェハ検査	フォトレジスト解析、他	洗浄・エッチング
開発中(共同評価) 	新事業(パッケージ技術) 	開発中(ボトル内側) 
SiC検査装置	L/S=0.5μm用材料開発用	酸素・水透過防止成膜

FPD装置事業：トップサプライヤーとしてのポジションを堅持

- 1. カラーフィルター用露光装置、検査装置が主力
 - ✓ G10.5用露光装置はシェア100%
 - ✓ キャッシュカウビジネスの位置づけ
- 2. 既存工場能力増強投資は一服
 - ✓ 新興国(インド)のG10.5投資に注目
- 3. 中国現地生産の推進、ビジネスのインド展開の準備

主力製品

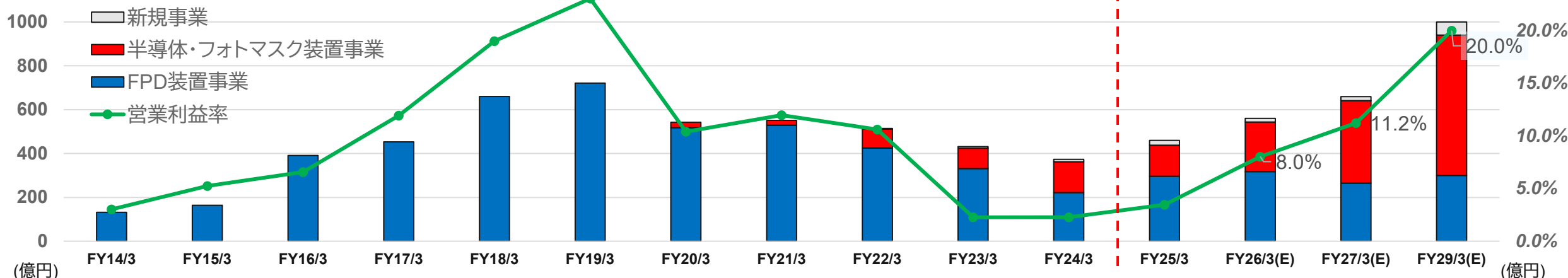
カラーフィルター露光(RZ) 欠陥修正(Jupiter)



5. 企業価値向上に向けて

2026年3月期中間決算
5. 企業価値向上に向けた
成長戦略と事業の状況

売上高(左軸)と営業利益率(折れ線・右軸)の推移



最終利益の極大化(売上増)

1. 既存ビジネスの伸長
2. 新規ビジネスの取組
3. M&Aによる事業拡大、経営基盤の強化
4. インドへの事業展開

最終利益の極大化(利益率UP)

1. 高利益率事業へのシフト
 - ・ 不採算事業からの撤退、高付加価値製品事業への取組・伸長、中国国産化
2. コストダウン
 - ・ 生産拠点のグローバル化の進展、リードタイム短縮、子会社統合・再編

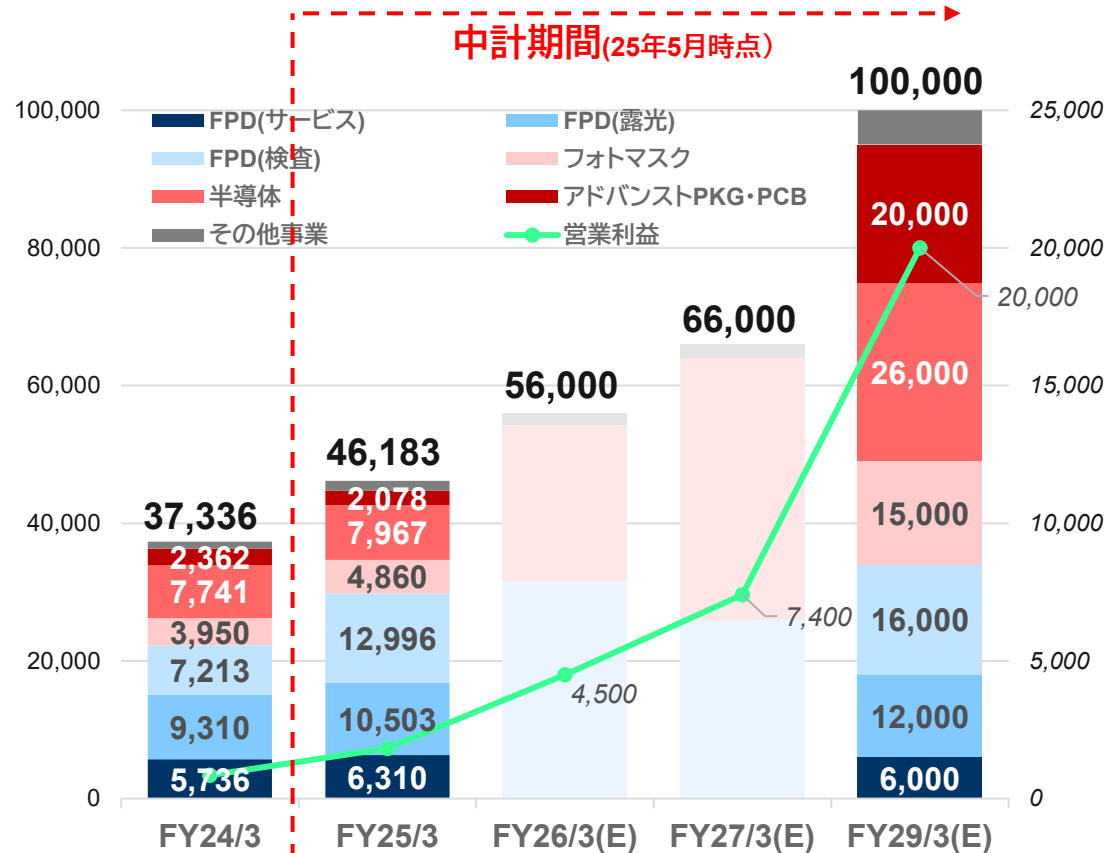
株主還元の取組

1. 利益水準に応じた積極的な配当
2. タイムリーな自社株買い

6. 中期経営計画について

- 期初の業績予想から変更無し、半導体フォトマスク装置事業、特にアドバンストパッケージ・PCBに注力
- FY27/3以降の成長ドライバ……半導体はNSS新製品、アドバンストパッケージはDIの成長

FY24/3～25/3の実績及び、FY26/3以降の売上利益予想



各事業セグメントで狙う市場、主力製品

	セグメント	狙う市場	主力製品
半導体 フォトマスク	アドバンストパッケージ・PCB	・半導体パッケージ基板 ・汎用PCB基板	DI露光、O/Sテスター
	半導体	・シリコンウェハ ・フォトレジスト、他	・検査 ・マスクレス露光 ・コーデベ、他
	フォトマスク	・レガシー半導体 ・FPD	検査、修正、測定、他
FPD	検査	LCD、OLED、他	検査、修正、測定、他
	露光	LCD、他	カラーフィルター露光 光配向露光、他
	アフターサービス	LCD、OLED、他	納入済製品のサービス

6. 主要財務データ

1. セグメント別受注高・売上高の詳細 (単位:百万円)

項目	2024/3	2025/3	2026/3 予想	2024/3				2025/3				2026/3				
				1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	構成比	QoQ%	YoY%
受注	37,788	52,747	—	9,264	11,210	6,716	10,598	9,880	7,681	8,901	26,285	9,262	8,089	100.0%	-12.7%	5.3%
FPD装置	20,254	34,716	—	6,433	5,077	4,174	4,569	7,237	3,248	2,511	21,721	5,347	3,957	48.9%	-26.0%	21.8%
検査	7,898	13,325	—	1,037	3,604	2,285	973	2,944	1,731	1,137	7,513	1,839	757	9.4%	-58.8%	-56.3%
製造	6,839	15,168	—	4,339	-1	554	1,948	2,905	0	258	12,005	2,287	1,328	16.4%	-41.9%	—
メンテナンス	5,517	6,224	—	1,058	1,475	1,336	1,649	1,388	1,516	1,116	2,204	1,220	1,872	23.1%	53.4%	23.5%
半導体・フォトマスク	16,444	16,562	—	2,592	5,872	2,283	5,763	2,255	4,120	6,037	4,151	3,547	3,800	47.0%	7.1%	-7.8%
フォトマスク	6,670	2,645	—	250	2,790	484	3,146	590	700	1,351	4	0	2,040	25.2%	—	191.4%
半導体(ウェハ製造、ラボ等)	7,549	9,393	—	2,281	1,988	1,299	1,982	960	2,564	3,151	2,719	2,598	1,746	21.6%	-32.8%	-31.9%
アドバンストパッケージ・PCB	2,226	4,524	—	63	1,095	500	634	705	856	1,536	1,428	949	14	0.2%	-98.5%	-98.4%
その他	1,090	1,469	—	239	261	258	266	388	314	354	413	368	332	4.1%	-9.8%	5.7%
半導体フォトマスク比率	43.5%	31.4%	—	28.0%	52.4%	34.0%	54.4%	22.8%	53.6%	67.8%	15.8%	38.3%	47.0%	—	8.7%	-6.7%
受注残高	37,788	43,664	46,000	40,162	44,787	44,734	37,788	37,456	32,316	31,737	43,664	44,928	41,272	100.0%	-8.1%	27.7%
FPD装置	19,899	24,877	—	24,204	24,978	26,571	19,899	19,497	14,147	10,586	24,877	26,840	24,216	59.7%	-9.7%	71.3%
半導体フォトマスク	17,200	18,857	—	15,958	19,809	18,162	17,200	17,959	18,168	21,151	18,857	18,087	17,055	40.3%	-5.8%	-6.2%
売上	37,336	46,183	56,000	5,749	6,585	6,769	18,231	9,523	12,822	9,479	14,358	7,999	11,744	100.0%	46.8%	-8.4%
FPD装置	22,259	29,809	31,689	4,133	4,303	2,581	11,242	7,639	8,598	6,071	7,501	3,314	6,580	56.0%	98.6%	-23.5%
検査	7,213	12,996	16,208	197	308	832	5,876	3,648	3,859	2,895	2,594	2,182	3,772	32.1%	72.9%	-2.3%
製造	9,310	10,503	9,333	2,620	2,599	314	3,777	2,591	3,065	1,654	3,193	266	767	6.5%	188.3%	-75.0%
メンテナンス	5,736	6,310	6,148	1,316	1,397	1,435	1,588	1,400	1,674	1,522	1,714	866	2,041	17.4%	135.7%	21.9%
半導体・フォトマスク	14,053	14,905	22,677	1,377	2,020	3,931	6,724	1,495	3,911	3,055	6,444	4,316	4,832	41.1%	12.0%	23.5%
フォトマスク	3,950	4,860	5,360	67	270	862	2,751	734	1,687	985	1,455	1,536	119	1.0%	-92.3%	-92.9%
半導体(ウェハ製造、ラボ等)	7,741	7,967	10,115	831	1,377	2,122	3,412	642	2,116	1,542	3,667	1,327	3,758	32.0%	183.2%	77.6%
アドバンストパッケージ・PCB	2,362	2,078	7,202	480	374	947	627	120	108	527	1,323	1,454	955	8.1%	-34.3%	784.3%
その他	1,024	1,469	1,634	239	261	258	266	388	314	354	413	368	332	2.8%	-9.8%	5.7%
半導体フォトマスク比率	37.6%	32.3%	40.5%	24.0%	30.7%	58.1%	36.9%	15.7%	30.5%	32.2%	44.9%	54.0%	41.1%	—	-12.8%	10.6%

2. 受注高および業績実績とガイダンス (単位:百万円)

項目	2018/3	2019/3	2020/3	2021/3	2022/3	2023/3	2024/3	2025/3	2026/3E	2025/3				2026/3			
										1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	Q/Q%	YoY%
受注高	109,323	47,430	22,532	36,980	53,200	37,072	37,788	52,747	—	9,879	7,682	8,901	26,285	9,262	8,089	-12.7%	5.3%
受注残高	115,637	90,935	59,145	40,939	42,721	36,647	37,100	43,664	46,000	37,456	32,316	31,737	43,664	44,928	41,271	-8.1%	27.7%
売上高	66,067	72,132	54,322	55,186	51,418	43,146	37,335	46,182	56,000	9,523	12,822	9,479	14,358	7,998	11,746	46.9%	-8.4%
売上総利益	21,321	25,144	15,122	15,704	15,486	10,946	10,604	12,130	—	1,773	3,375	2,547	4,435	1,854	2,658	43.4%	-21.2%
営業利益	12,545	16,628	5,653	6,604	5,461	986	846	1,821	4,500	-948	812	192	1,765	-514	144	—	-82.3%
営業外収益	55	209	623	395	518	935	551	517	—	287	-154	353	31	139	59	-57.6%	-138.3%
営業外費用	230	70	121	163	111	222	285	447	—	97	175	76	99	215	19	-91.2%	-89.1%
経常利益	12,370	16,767	6,156	6,836	5,868	1,700	1,112	1,891	4,200	-759	484	469	1,697	-589	183	—	-62.2%
税前利益	12,256	16,892	6,191	7,054	6,450	1,571	1,181	1,383	—	-721	504	451	1,149	-633	269	—	-46.6%
法人税等	3,399	4,517	2,054	2,462	2,194	1,434	603	781	—	-6	101	213	473	60	-194	—	—
親会社株主当期純利益	7,837	10,901	3,251	3,513	4,198	260	778	800	2,700	-656	438	271	747	-665	426	—	-2.7%
1株当たり当期純利益	1582.84	2217.48	336.29	363.41	434.21	26.92	80.65	84.07	265.71	-68.22	45.41	28.44	78.44	-70.46	44.64	—	—
1株当たり配当金	270	320	120	120	120	90	60	80	80	—	40	—	40	—	40	—	—
1株当たり純資産	3865.50	5552.32	2926.03	3233.74	3534.40	3475.25	3571.35	3544.98	—	—	—	—	3544.98	—	—	—	—
売上高総利益率	32.3%	34.9%	27.8%	28.5%	30.1%	25.4%	28.4%	26.3%	—	18.6%	26.3%	26.9%	30.9%	23.2%	22.6%	-0.6%	-3.7%
売上高営業利益率	19.0%	23.1%	10.4%	12.0%	10.6%	2.3%	2.3%	3.9%	8.0%	-10.0%	6.3%	2.0%	12.3%	-6.4%	1.2%	7.7%	-5.1%
売上高経常利益率	18.7%	23.2%	11.3%	12.4%	11.4%	3.9%	3.0%	4.1%	7.5%	-8.0%	3.8%	4.9%	11.8%	-7.4%	1.6%	8.9%	-2.2%
法人税率	27.7%	26.7%	33.2%	34.9%	34.0%	91.3%	51.1%	56.5%	—	0.8%	20.0%	47.2%	41.2%	-9.5%	63.9%	73.4%	43.9%
売上高当期純利益率	11.9%	15.1%	6.0%	6.4%	8.2%	0.6%	2.1%	1.7%	4.8%	-6.9%	3.4%	2.9%	5.2%	-8.3%	3.6%	11.9%	0.2%
自己資本利益率(ROE)	40.9%	40.6%	11.5%	11.2%	12.7%	0.8%	2.3%	2.4%	8.2%	-2.0%	1.3%	0.8%	2.2%	-2.0%	1.3%	3.3%	0.0%
自己資本	19,139	26,844	28,293	31,268	32,980	32,842	34,372	33,500	—	33,611	32,976	33,153	33,500	32,634	33,172	171	-171

3. 貸借対照表・キャッシュフロー計算書 (単位:百万円)

項目	2018/3	2019/3	2020/3	2021/3	2022/3	2023/3	2024/3	2025/3	2025/3				2026/3			
									1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	Q/Q%	YoY%
資産の部																
現金及び預金	22,281	19,836	12,101	33,278	27,898	26,729	23,096	26,671	25,063	28,930	26,196	26,671	23,129	19,952	-13.7%	-31.0%
受取手形・売掛金	21,019	25,518	24,132	19,329	19,537	22,408	24,716	19,786	20,332	21,681	20,181	19,786	18,085	21,598	19.4%	-0.4%
棚卸資産	14,071	24,028	24,854	15,956	11,405	10,089	15,531	15,495	16,408	15,052	17,057	15,495	18,196	18,131	-0.4%	20.5%
商品及び貯蔵品	227	171	123	196	176	338	477	679	443	787	788	679	941	625	-33.6%	-20.6%
仕掛品	13,118	22,756	23,126	13,977	9,428	7,219	12,274	10,707	12,881	11,374	12,951	10,707	12,612	13,545	7.4%	19.1%
原材料及び貯蔵品	726	1,101	1,605	1,783	1,801	2,532	2,780	4,109	3,084	2,891	3,318	4,109	4,643	3,961	-14.7%	37.0%
流動資産	62,209	74,699	66,494	71,379	63,085	62,621	67,045	65,392	65,537	69,073	67,255	65,392	62,922	63,018	0.2%	-8.8%
有形固定資産	977	3,274	4,539	4,382	4,720	4,034	4,098	3,859	4,305	4,261	4,221	3,859	4,403	4,443	0.9%	4.3%
無形固定資産	253	189	1,592	1,625	1,495	1,460	886	712	1,000	957	879	712	648	586	-9.6%	-38.8%
投資その他の資産	1,344	2,141	2,493	3,203	3,300	3,270	3,575	3,235	3,553	3,190	3,105	3,235	3,157	3,619	14.6%	13.4%
資産合計	64,786	80,304	75,119	80,591	72,601	71,387	75,606	73,201	74,397	77,483	75,461	73,201	71,132	71,668	0.8%	-7.5%
負債の部																
支払手形・買掛金	10,861	12,505	8,095	6,477	6,323	4,039	5,429	4,918	5,296	4,778	4,932	4,918	5,735	5,031	-12.3%	5.3%
短期借入金	2,491	2,450	200	120	394	663	866	1,295	1,386	1,704	1,685	1,295	1,297	1,868	44.0%	9.6%
前受金	14,868	22,320	18,202	15,061	8,334	8,221	4,496	5,037	5,645	5,638	5,113	5,037	5,563	5,892	5.9%	4.5%
流動負債	40,963	50,517	36,539	34,195	27,061	23,922	29,299	24,263	29,905	26,474	25,650	24,263	24,404	25,078	2.8%	-5.3%
長期借入金	2,256	1,332	8,861	12,964	10,243	12,662	10,550	14,254	9,482	16,745	15,420	14,254	12,819	12,167	-5.1%	-27.3%
純資産	21,114	27,985	29,361	32,195	34,540	33,884	34,639	33,581	33,841	33,154	33,300	33,581	32,691	33,258	1.7%	0.3%
自己資本	19,139	26,844	28,293	31,268	34,175	33,604	34,372	33,500	33,611	32,976	33,153	33,500	32,634	33,172	1.6%	0.6%
連結CF																
営業活動によるCF	8,526	6,531	-7,853	20,173	1,408	-3,284	-4,764	5,344	—	—	—	—	—	—	—	—
投資活動によるCF	-434	-2,617	-3,828	-1,251	-1,554	-1,195	-440	-1,470	—	—	—	—	—	—	—	—
フリーキャッシュ・フロー	8,092	3,914	-11,681	18,922	-146	-4,479	-5,204	3,874	—	—	—	—	—	—	—	—
自己株式取得	-	-1,999	0	-512	0	0	-99	-499	—	—	—	—	—	—	—	—
配当金支払額	-866	-1,634	-1,547	-974	-1,176	-1,176	-588	-675	—	—	—	—	—	—	—	—
財務活動によるCF	-2,150	-6,385	4,074	1,972	-5,839	2,780	1,526	-471	—	—	—	—	—	—	—	—

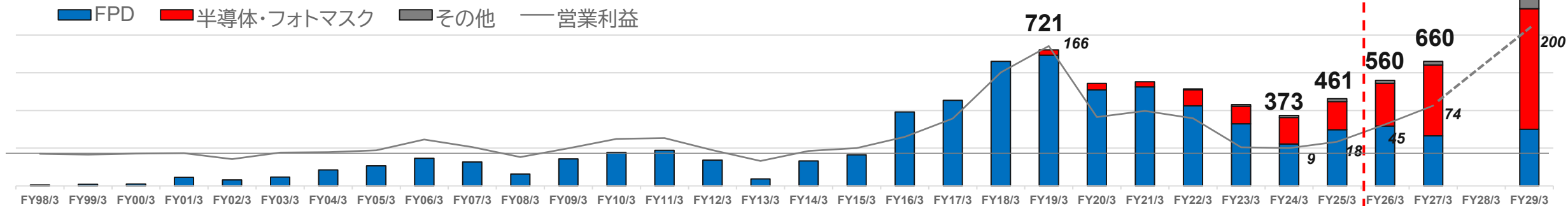
7. 付属資料

1. FPDから半導体へ ～事業成長と、M&A + R&Dによる製品群拡大の歴史～

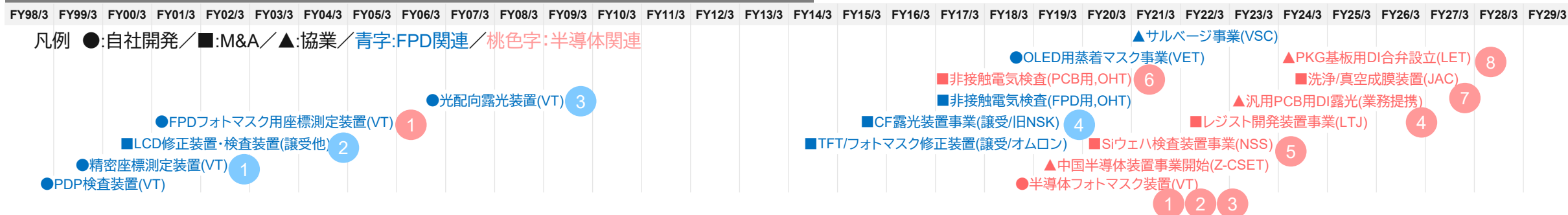
2026年3月期中間決算
6. 主要財務データ

30

売上高と営業利益の推移(単位:億円)

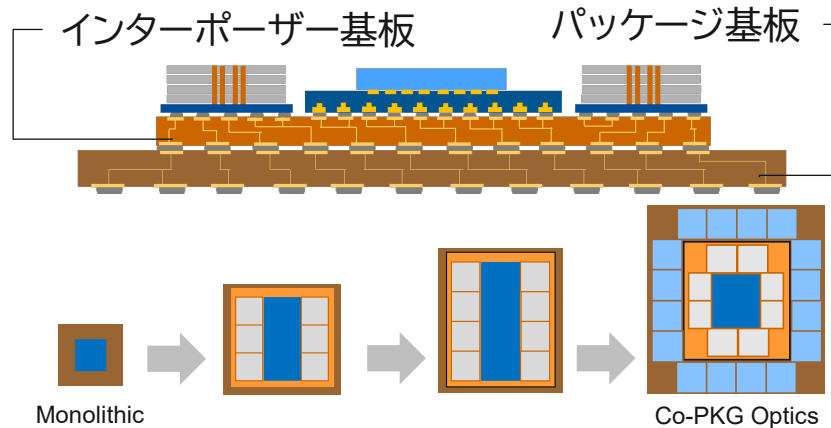


M&Aと自社R&Dによる事業拡大の歴史



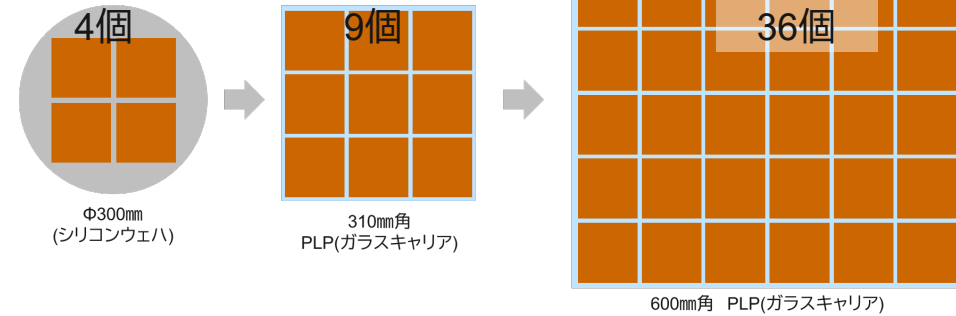
2. AI用半導体パッケージの大型化と当社製品

先端基板の進化(大型化/多層化/微細化)

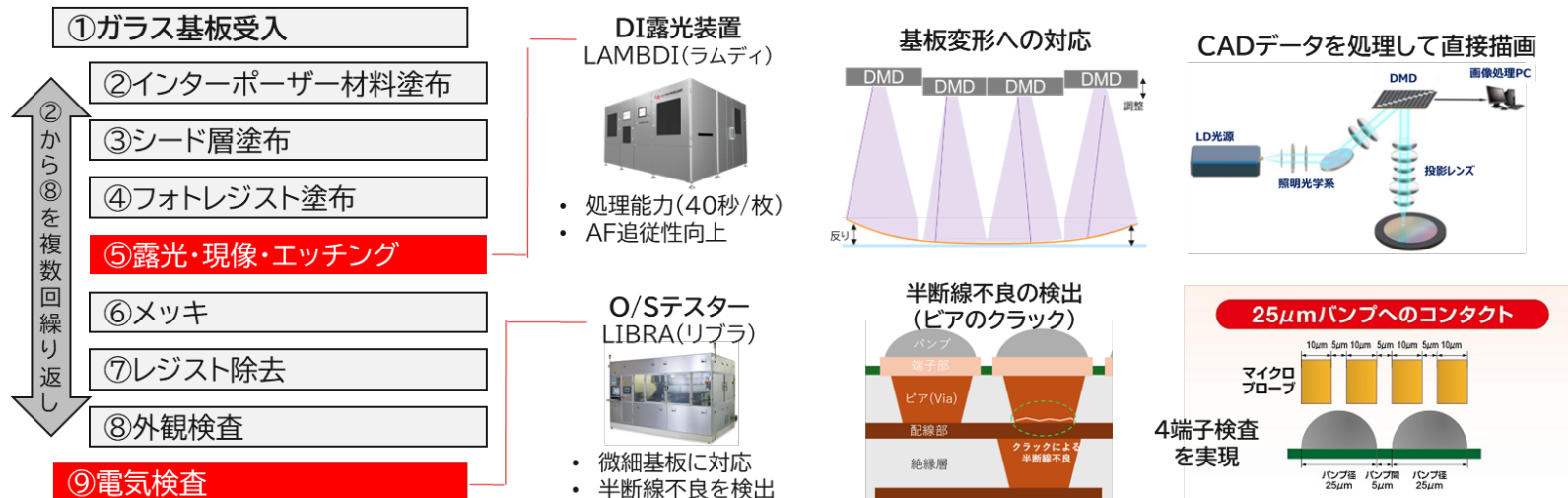


大型化するインターポージャーへの対応(PLPの採用)

反り・歪み・層間位置ずれへの対応が課題に



樹脂インターポージャー製造工程例と、当社製品および特長



3. 事業セグメントについて

事業セグメント	サブセグメント	関連市場	主力製品	バイ・テクノロジーグループ
半導体・ フォトマスク	アドバンストパッケージ・ PCB	・アドバンストパッケージ ・汎用PCB基板	・DI露光 ・O/Sテスター	・ LE-TECHNOLOGY ・ オー・エイチ・ティー ・ バイ・テクノロジー
	半導体	・シリコンウェハ ・フォトレジスト ・半導体試作、他	・検査 ・ラボ用現像 ・マスクレス露光、他	・ ナノシステムソリューションズ ・ リソテックジャパン ・ ジャパンクリエイト
	フォトマスク	・レガシー半導体用フォトマスク ・FPD用フォトマスク	検査関連、他	バイ・テクノロジー
FPD	検査	LCD、OLED、その他の用途	検査関連、他	・ バイ・テクノロジー ・ オー・エイチ・ティー
	露光	LCD、その他の用途	カラーフィルター露光、 光配向露光、他	バイ・テクノロジー
	アフターサービス	LCD、OLED、その他の用途	製品のサービス、他	バイ・テクノロジー、他

注記事項

・将来見通し

本資料に記載されている当社の計画、戦略、見通し及びその他の歴史的事実でないものは、将来に関する見通しであり、これらは現在入手可能な期待、見積、予想に基づいています。これらの期待、見積、予想は、経済情勢・市況の変化、競争環境の変化、顧客のある国の政策変化、係争中及び将来の訴訟の結果など多くの潜在的リスク、不確実な要素、過程の影響を受けますので、実際の業績は見通しから大きく異なる結果となる可能性があります。従って、これら将来予想に関する記述に全面的に依拠することは差し控えて頂きますようお願いいたします。また、当社は新しい情報、将来の出来事などに基づきこれらの将来予測を更新する義務を負うものではありません。

・数字の処理

記載された金額は、単位未満を切り捨て処理、比率は単位金額で処理した結果を四捨五入している為、内訳と一致しない場合があります。

・事業セグメントの構成

✓ 半導体・フォトマスク装置事業

半導体製造工程における製造装置、検査装置及びフォトマスク用装置等の開発・設計・製造・販売・関連サービス、及びPCB用装置で構成されています。

✓ FPD装置事業

FPD製造工程における製造装置、検査装置等の開発、設計、製造、販売、関連サービス及びOLED用蒸着マスクをはじめとする部材等で構成されています。

お問合せ先
IR室
vtj-ir@vtec.co.jp

